

2021年日本东京国际电子元器件博览NEPCON JAPAN/2022年NEPCON JAPAN

产品名称	2021年日本东京国际电子元器件博览NEPCON JAPAN/2022年NEPCON JAPAN
公司名称	广东天涯展览有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道胜和社区鸿福西路国际商会大厦905（注册地址）
联系电话	18680620919

产品详情

展会名称：日本东京国际电子元器件博览会

展会日期：2021年1月20-22日

展会地点：Tokyo Big Sight, Japan

展会周期：一年一届

展会介绍

作为“电子封装&制造”的综合展会，自1972年举办至今，NEPCON JAPAN随着日本电子行业的发展也在不断的成长壮大。在2000年，主办方增设了IC封装技术、PCB及电子组件的部分，进一步提高了展会的价值，使NEPCON JAPAN成为“电子设计、研发与制造领域的国际性综合展会”。近年来，在此规模基础上又新增了关于汽车电子、电动汽车、可穿戴式设备以及LED/OLED照明技术等拥有良好发展前景的同期展会，使得NEPCON JAPAN作为了解“未来电子产业”新技术的场所而备受业界瞩目。近几年，来自中国、韩国、台湾的参展商以及观展人士不断增加，NEPCON JAPAN已经成为了名副其实的“代表亚洲电子产业”的综合性展览会，也是亚洲的电子设计、研发与制造方面的展览会。该展将是中国电子行业的众多厂商开拓国际市场、了解前沿技术及寻找潜在商机的平台。

展品范围：

1、电容器、变压器、电感器、线圈、电阻器、IC、滤波器、谐振器/振荡器、相关晶体产品、LED、转换器、继电器、磁接触器、断路器、存储卡、声波元件、熔断器、马达、模块、传感器、开关电源、电池。

2、触摸屏、大容量DRAM、通信模块、摄像头模组、内部基材、高性能处理器、大容量闪存、传感器、多层PWB/PCB、积层PWB/PCB。

3、散热设计/降噪组件&材料区、被动元件区、连接器&线缆区、传感器区

4、刚性PCB、多层PCB、柔性PCB、多层柔性PCB、软硬结合、积层板、半导体封装PCB、TOB/COF PCB、光学PCB、EPD、其它PCB。

5、刚性覆铜箔层压板、柔性覆铜箔层压板、防护板、多层PCB半固化片、铜箔、绝缘材料。

6、功能设计/逻辑设计工具、模式/布线设计工具、CAD/CAM/CIM、传输线路模拟器、SI/PI/EMC分析、热分析、设计数据控制工具。

7、契约设计服务、契约开发服务、原型开发服务、咨询服务。

我们的地址：东莞市南城区国际商会大厦907 联系人：杨小姐 联系手机：18680620919 期待您的咨询